ON Semiconductor®

Initial Product/Process Change Notification

Document #:IPCN22759XA
Issue Date:21 Nov 2019

Title of Change:	SSOT3 (SOT23 3L) Capacity expansion of Assembly and Test operations of ON Cebu to ON Seremban, Malaysia.
Proposed First Ship date:	28 Jun 2020 or earlier if approved by customer
Contact Information:	Contact your local ON Semiconductor Sales Office or RamilAngelo.Nonato@onsemi.com
PCN Samples Contact:	Contact your local ON Semiconductor Sales Office or <PCN.samples@onsemi.com>. Sample requests are to be submitted no later than 30 days from the date of first notification, Initial PCN or Final PCN, for this change. Samples delivery timing will be subject to request date, sample quantity and special customer packing/label requirements.
Type of Notification:	This is an Initial Product/Process Change Notification (IPCN) sent to customers. An IPCN is an advance notification about an upcoming change and contains general information regarding the change details and devices affected. It also contains the preliminary reliability qualification plan.The completed qualification and characterization data will be included in the Final Product/Process Change Notification (FPCN). This IPCN notification will be followed by a Final Product/Process Change Notification (FPCN) at least 90 days prior to implementation of the change. In case of questions, contact <PCN.Support@onsemi.com>
Marking of Parts/ Traceability of Change:	Customer may receive the parts from ON Semiconductor Seremban, Malaysia from month of June 2020 onwards once FPCN expire. Parts from ON Semiconductor Seremban, Malaysia can be identified through product marking which follow ON Semiconductor marking format.
Change Category:	Assembly Change, Test Change
Change Sub-Category(s):	Material Change, Shipping/Packaging/Marking, Manufacturing Site Addition

Sites Affected:

ON Semiconductor Sites	**External Foundry/Subcon Sites**
ON Semiconductor Cebu, Philippines	None
ON Semiconductor Seremban, Malaysia	

Description and Purpose:

	Before Change Description	**After Change Description**	
Assembly & Test site	**ON Cebu, Philippines**	**ON Cebu, Philippines**	**ON Seremban, Malaysia**
Wire	Au wire & Cu wire	Cu wire	Cu wire
Mold Compound	CK5000A(PMC)	CK5000A(PMC)	G600FB
Case outline	527AG	New Composite Case Outline - TBA (to support both SBN and Cebu pkg dimensions)	
Marking	Ex-Fcs format marking	Ex-FCS format marking	ON Format marking

Qualification Plan:

QV DEVICE NAME: FDN537N
RMS: F56347
PACKAGE: SOT23 3L CU SNGL HPBF

Test	Specification	Condition	Interval
HTRB	JESD22-A108	Ta= 150 °C, 80% max rated V	1008 hrs
HTGB	JESD22-A108	Ta= 150 °C, 100% max rated Vgss	1008 hrs
HTSL	JESD22-A103	Ta= 150 °C	1008 hrs
IOL	MIL-STD-750 (M1037) AEC-Q101	Ta=+25°C, delta Tj=100°C On/off = 2 min	15000 cyc
TC	JESD22-A104	Ta= -55°C to + 150°C	1000 cyc
HAST	JESD22-A110	130°C, 85% RH, 18.8psig, bias	192 hrs
uHAST	JESD22-A118	130°C, 85% RH, 18.8psig, unbiased	96 hrs
PC	J-STD-020 JESD-A113	MSL 1 @ 260°C	
RSH	JESD22- B106	Ta = 265C, 10 sec	
SD	JSTD002	Ta = 245C, 10 sec	

QV DEVICE NAME: FDN86246
RMS: 55512
PACKAGE: SOT23 3L CU SNGL HPBF

Test	Specification	Condition	Interval
HTRB	JESD22-A108	Ta= 150 °C, 80% max rated V	1008 hrs
HTGB	JESD22-A108	Ta= 150 °C, 100% max rated Vgss	1008 hrs
HTSL	JESD22-A103	Ta= 150 °C	1008 hrs
IOL	MIL-STD-750 (M1037) AEC-Q101	Ta=+25°C, delta Tj=100°C On/off = 2 min	15000 cyc
TC	JESD22-A104	Ta= -55°C to + 150°C	1000 cyc
HAST	JESD22-A110	130°C, 85% RH, 18.8psig, bias	192 hrs
uHAST	JESD22-A118	130°C, 85% RH, 18.8psig, unbiased	96 hrs
PC	J-STD-020 JESD-A113	MSL 1 @ 260°C	
RSH	JESD22- B106	Ta = 265C, 10 sec	
SD	JSTD002	Ta = 245C, 10 sec	

List of Affected Parts:

Note: *Only the standard (off the shelf) part numbers are listed in the parts list. Any custom parts affected by this PCN are shown in the customer specific PCN addendum in the PCN email notification, or on the* ***PCN Customized Portal.***

Part Number	Qualification Vehicle
FDN028N20	FDN537N
FDN537N	FDN537N
FDN8601	FDN86246
FDN86246	FDN86246
FDN86265P	FDN86246
FDN86501LZ	FDN86246

Japanese translation of the notification starts here.

通知の日本語訳はここから始まります。

Note*: The Japanese version is for reference only. In case of any differences between the English and Japanese version, the English version shall control.*

注：日本語版は参照用です。英語版と日本語版の違いがある場合は、英語版が優先されます.

ON Semiconductor®

初回製品 / プロセス変更通知

文書番号# : IPCN22759XA
発行日 : 21 Nov 2019

変更件名 :	オン セブにおける SSOT3 (SOT23 3L)の組立および検査 オペレーションの能力を、オン・セレンバン（マレーシア）に拡大	
初回出荷予定日 :	28 June 2020 またはお客様からの承認が得られた場合はそれ以前	
連絡先情報 :	現地のオン・セミコンダクター営業所または <RamilAngelo.Nonato@onsemi.com> にお問い合わせください。	
サンプル :	サンプルは認定完了後に提供が可能となります。 現地のオン・セミコンダクター営業所または <PCN.Samples@onsemi.com> にお問い合わせください。 サンプルは、この変更の初回通知、初回 PCN の日付から 30 日以内に要求してください。	
通知種別 :	これは、お客様宛の初回製品 / プロセス変更通知 (IPCN) です。IPCN は、近日中に実施される変更に関する事前通知であり、変更の詳細および影響を受けるデバイスについての一般情報が記載されます。また、暫定的な信頼性認証計画も記載されます。 最終的な認定データおよび特性データは最終製品 / プロセス変更通知 (FPCN) に含まれます。この IPCN は、変更実施から少なくとも 90 日前に発行される最終製品 / プロセス変更通知 (FPCN) に先だって通知されます。ご不明な点がありましたら、<PCN.Support@onsemi.com> にお問い合わせください。	
製品マーキング/変更のトレーサビリティ :	お客様はオン・セミコンダクター セレンバン（マレーシア）からの製品を、FPCN の有効期限切れ後の 2020 年 6 月以降から受け取ることができます。オン・セミコンダクター セレンバン（マレーシア）からの製品は、オン・セミコンダクターのマーキングフォーマットに準拠した製品マーキングにより識別できます	
変更カテゴリ :	アセンブリの変更, 試験の変更	
変更サブカテゴリ :	製造拠点の追加, 材料の変更, 出荷/パッケージング/表記	
影響を受ける拠点 :	オン・セミコンダクター拠点 : ON Semiconductor Cebu, Philippines ON Semiconductor Seremban, Malaysia	外部製造工場 / 下請業者拠点 : なし

説明および目的 :

	変更前の表記	変更後の表記	
組立＆検査拠点	**ON Cebu, Philippines**	**ON Cebu, Philippines**	**ON Seremban, Malaysia**
ワイヤー	Au ワイヤおよび Cu ワイヤ	Cu ワイヤ	Cu ワイヤ
モールド・コンパウンド	CK5000A(PMC)	CK5000A(PMC)	G600FB
ケースアウトライン	527AG	新しい複合のケースアウトライン - TBA （セレンバンとセブの両方のパッケージ寸法をサポート	
製品マーキング	Ex-FCS フォーマットでマーキング	Ex-FCS フォーマットでマーキング	ON フォーマットでマーキング

認定計画:

デバイス名 : FDN537N
RMS: F56347
パッケージ : SOT23 3L CU SNGL HPBF

テスト	仕様	条件	間隔
HTRB	JESD22-A108	Ta= 150 °C, 80% max rated V	1008 hrs
HTGB	JESD22-A108	Ta= 150 °C, 100% max rated Vgss	1008 hrs
HTSL	JESD22-A103	Ta= 150 °C	1008 hrs
IOL	MIL-STD-750 (M1037) AEC-Q101	Ta=+25°C, delta Tj=100°C On/off = 2 min	15000 cyc
TC	JESD22-A104	Ta= -55°C to + 150°C	1000 cyc
HAST	JESD22-A110	130°C, 85% RH, 18.8psig, bias	192 hrs
uHAST	JESD22-A118	130°C, 85% RH, 18.8psig, unbiased	96 hrs
PC	J-STD-020 JESD-A113	MSL 1 @ 260°C	
RSH	JESD22- B106	Ta = 265C, 10 sec	
SD	JSTD002	Ta = 245C, 10 sec	

デバイス名 : FDN86246
RMS: 55512
パッケージ : SOT23 3L CU SNGL HPBF

テスト	仕様	条件	間隔
HTRB	JESD22-A108	Ta= 150 °C, 80% max rated V	1008 hrs
HTGB	JESD22-A108	Ta= 150 °C, 100% max rated Vgss	1008 hrs
HTSL	JESD22-A103	Ta= 150 °C	1008 hrs
IOL	MIL-STD-750 (M1037) AEC-Q101	Ta=+25°C, delta Tj=100°C On/off = 2 min	15000 cyc
TC	JESD22-A104	Ta= -55°C to + 150°C	1000 cyc
HAST	JESD22-A110	130°C, 85% RH, 18.8psig, bias	192 hrs
uHAST	JESD22-A118	130°C, 85% RH, 18.8psig, unbiased	96 hrs
PC	J-STD-020 JESD-A113	MSL 1 @ 260°C	
RSH	JESD22- B106	Ta = 265C, 10 sec	
SD	JSTD002	Ta = 245C, 10 sec	

影響を受ける部品の一覧:

注: 部品一覧には標準部品番号 (既製品) のみが記載されています。本 PCN の影響を受けるカスタム部品番号は、PCN メールで提供される顧客個別の付録、または PCN カスタマイズポータルに記載されています。

部品番号	認定試験用ビークル
FDN86501LZ	FDN86246
FDN86265P	FDN86246
FDN86246	FDN86246
FDN8601	FDN86246
FDN537N	FDN537N
FDN028N20	FDN537N

Appendix A: Changed Products

Product	Customer Part Number	Qualification Vehicle	New Part Number	Replacement Supplier
FDN028N20		FDN537N		
FDN537N		FDN537N		
FDN8601		FDN86246		
FDN86246		FDN86246		
FDN86265P		FDN86246		
FDN86501LZ		FDN86246		